

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-043

成都硅宝科技股份有限公司

关于对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司硅宝（上海）新材料有限公司【以下简称“硅宝（上海）”】近日竞拍取得上海市闵行区规划和自然资源局挂牌出让的“闵行区莘庄工业区 MHP0-0501 单元 61A-06A 地块（颛桥镇工-368）”地块，并与上海市闵行区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合同》）。根据《出让合同》约定，硅宝（上海）2025 年 7 月 2 日已支付全部国有建设用地使用权出让价款（以下简称“土地出让价款”）。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、2023年12月14日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在上海市投资15,000万元设立全资子公司建设有机硅先进材料研发及产业化项目。具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-066）。

2、2024年1月2日公司与上海市闵行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，公司决定在上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约16亩工业用地，投资15,000万元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨签订投资协议书的公告》（公告编号：2024-001）。

3、2024年2月硅宝（上海）完成工商注册登记，并取得由上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资

讯网上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-005）。

二、对外投资进展情况

硅宝（上海）近日竞拍取得上海市闵行区规划和自然资源局以挂牌方式出让的“闵行区莘庄工业区 MHP0-0501 单元 61A-06A 地块（颛桥镇工-368）”地块的国有建设用地使用权，并与上海市闵行区规划和自然资源局签订了《出让合同》。2025 年 7 月 2 日硅宝（上海）已支付全部土地出让价款。

三、交易标的主要情况

出让人：上海市闵行区规划和自然资源局

受让人：硅宝（上海）新材料有限公司

宗地编号：202512609208018209

宗地位置：上海市闵行区颛桥镇

宗地面积：10667.37平方米

宗地用途：工业用地

出让年限：20年

四、对公司的影响

本次交易事项有利于公司加速推进有机硅先进材料研究及产业化开发项目建设，有利于公司利用上海国际化优势，吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研发实力，增强公司核心竞争能力，符合公司战略规划及经营发展需要。

本次交易的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

公司将根据有关规定及时办理相关权属证书，积极推进项目建设。后续项目的实施可能会受有关部门审批手续、有关政策调整等因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《上海市国有建设用地使用权出让合同》；

2、《国内支付业务付款回单》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 07 月 02 日